精选快讯　金融快讯　2026年11月12日 16:00

上海芯片公司集益威回复科创板IPO问询，拟募资30亿元研发高速互连芯片

要点

- 集益威半导体（上海）股份有限公司发布了首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复。
- 集益威采用Fabless经营模式，不直接从事生产活动，主要负责芯片、IP的设计及产品质量管控。
- 报告期各期，集益威向前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为100%、97.3%、91.6%和76.17%。

集益威半导体（上海）股份有限公司发布了首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复。集益威的保荐人为国泰海通证券。集益威主营高速互连芯片、IP及相关定制专用芯片的研发、设计与销售。集益威的客户包括中际旭创、国芯科技等。集益威吸引了中国移动链长基金、阿里云计算、腾讯创投等机构入股。

集益威采用Fabless经营模式，不直接从事生产活动，主要负责芯片、IP的设计及产品质量管控。2023年至2026年上半年，集益威主要芯片销售业务的营收占比从13.93%提升至48.81%。2023年至2026年上半年，集益威高速互连IP授权的营收占比从18.75%提升至49.54%。2023年至2026年上半年，集益威NRE及其他业务的营收占比从67.32%降至1.65%。报告期内，集益威前五大供应商采购金额占当期采购总额比例分别为87.39%、87.55%、75.49%和83.19%。

报告期各期，集益威向前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为100%、97.3%、91.6%和76.17%。2023年、2024年、2025年、2026年上半年，集益威的营业收入分别约0.16亿元、3.1亿元、3.89亿元、2.82亿元。2023年、2024年、2025年、2026年上半年，集益威的净利润分别约-1.27亿元、-3639.91万元、1263.94万元、6221.83万元。2025年末及2026年6月末，集益威累计未分配利润分别为-1686.42万元、4535.42万元。

报道来源：21jingji

来源网站：https://www.inews.today/